

2012年3月1日

SICAS 統計の 2011 年第 4 四半期(10 - 12 月)の数値公表

SICAS 統計(世界半導体生産キャパシティ統計)の 2011 年第 4 四半期(10 - 12 月)の数値がまとまりましたので公表致します。生産能力の数字は、断りのない限り 8 インチウェハ換算の数字です。

**【総括】**

2011 年第 4 四半期(4Q)の IC 合計(MOS IC+バイポーラ)の生産能力は 1835.6 千枚/週となり、2011 年第 3 四半期(3Q)の 1783.6 千枚/週から+2.9%の増加となった。一方、同 4Q の IC 合計の実投入数は 1616.2 千枚/週と、前期(3Q)の 1627.2 千枚/週から-0.7%減少し、同 4Q の IC 合計の生産稼働率は 88.0%と、前期(3Q)の 91.2%と比べ-3.2%ポイント低い値を示した。

2011 年 4Q の半導体合計(IC 合計+ディスクリート計)の生産能力は 2038.2 千枚/週となり、前期(3Q)の 1988.8 千枚/週から+2.5%の増加となった。一方、同 4Q の半導体合計の実投入数は 1757.7 千枚/週と、前期(3Q)の 1801.9 千枚/週から-2.5%減少し、同 4Q の半導体合計の生産稼働率は 86.2%と、前期(3Q)の 90.6%と比べ-4.4%ポイント低い値を示した。

**【概要】**

1. 生産能力

MOS 計の 2011 年 4Q の生産能力は 1793.0 千枚/週となり、前期(3Q)の 1740.7 千枚/週から+3.0%の増加となった。

2. 稼働率

MOS 計の 2011 年 4Q の生産稼働率は 88.9%となり、前期(3Q)の 91.7%と比べ-1.8%ポイント低下した。

3. ウェハサイズ別まとめ

MOS 計に占める 8 インチウェハの生産能力は、2011 年 4Q は 439.8 千枚/週となり、前期(3Q)の 432.9 千枚/週から+1.6%増加した。また、MOS 計に占める 12 インチ(300 mm)ウェハの同 4Q の生産能力は、8 インチ換算で 1222.9 千枚/週(12 インチ実枚数では 543.5 千枚/週)と前期(3Q)から+3.5%の増加を示し、同生産稼働率は 95.9%と、前期比では-0.5%ポイントの低下ながらも、高い水準を示した。

(参加会社を含む諸データの詳細は別添をご参照ください。)

## 【データ収集】

SICAS に参加している IC メーカーは、年 4 回、四半期毎に、その IC 生産能力と実投入数を地域別に委託した第三者のデータ集計機関に提出し、そこで集計された数値が最後に中央集計機関によりまとめられ、世界計の集計データとなり発表されます。

データの秘密保持のため、会員を含むいかなる関係者(データ集計機関を除く)も、公表される「世界計のデータ」以外を知り得ない仕組みとなっています。

参加会員は、各々自社の世界全体の生産能力と実投入数を連結ベースで把握し報告しますが、他の IC メーカーに生産委託している部分は含みません。生産能力・実投入数のいずれもウェハ枚数を単位とし、集計期間内の総数を週当たりの平均値に換算し「千枚/週」の単位で報告します。報告方法は、以下のとおりです。

(1) 半導体合計 = IC 合計 + ディスクリート合計

(2) IC 合計 = MOS IC + バイポーラ IC の体系となります。( \* インチ換算にご注意ください。 )

MOS IC は、加工精度により 0.7 ミクロン以上、0.4 ミクロン以上 0.7 ミクロン未満、0.2 ミクロン以上 0.4 ミクロン未満、0.12 ミクロン以上 0.2 ミクロン未満、0.08 ミクロン以上 0.12 ミクロン未満、0.06 ミクロン以上 0.08 ミクロン未満及び 0.06 ミクロン未満に分けて 8 インチウェハの枚数に換算します。一方バイポーラ IC は、加工精度の区分なく 5 インチウェハの枚数に換算します。生産能力を計算する際は、1 年 = 52 週、1 週 = 7 日、1 日 = 24 時間の稼働を前提とします。

## 【組織概要】

SICAS は、世界の 5 業界団体 (EECA、JEITA、KSIA、SIA、TSIA)<sup>注1</sup> の支援の下に、1994 年に活動を開始しました。昨年、TSIA および台湾企業が退会したことに伴い、現在は、世界 4 極から主要半導体メーカー 19 社<sup>注2</sup> が会員として参加しております。なお、日本地域の運営組織として、SICAS Japan が 1995 年 1 月に設立され、2006 年 4 月からは、JEITA 傘下で SICAS 小委員会として活動を続けてまいりました。

(注1)

- |   |              |
|---|--------------|
| ・ EECA : European Electronic Component Manufacturers Association            | (欧州電子部品工業会)  |
| ・ JEITA : Japan Electronics & Information Technology Industries Association | (電子情報技術産業協会) |
| ・ KSIA : Korea Semiconductor Industry Association                           | (韓国半導体産業協会)  |
| ・ SIA : Semiconductor Industry Association (of the US)                      | (米国半導体工業会)   |
| ・ TSIA : Taiwan Semiconductor Industry Association                          | (台湾半導体産業協会)  |

(注2)

TSIA は、2011年に SICAS を退会。

## 【SICAS統計の終息】

なお、SICAS 統計は、2011 年中に参加企業に著しい変動があったために、2012 年第 1 四半期以降は、継続されない運びとなりました。本統計の読者の皆様におかれては、長きにわたって愛読していただき、誠にありがとうございました。

## 【お問い合わせ先】

SICAS 小委員会 (SICAS-Japan)

事務局: 一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体部会 電子デバイス部

電話: 03-5218-1061

URL: <http://www.jeita.or.jp>